

2017 INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE

2017 国际技术会议

2017 年国际技术会议分为两大方向：市场及技术。每个方向都特邀行业领袖、技术专家等专业人士作为主讲嘉宾，为大家分享最热门的议题和最新的市场趋势。

会议主要议题：

- 线路板市场概览及 PCB 技术发展趋势
- 人工智能和工业大数据推动新的制造业革新
- 实际工厂中利用数据驱动对准度管控智能制造
- 智能手机及通讯设备的线路板要求
- 先进三维互连技术
- 未来汽车产品对 PCB 的挑战和发展
- 高性能化学镍金的技术进展
- PCB/PCBA 的清洗趋势和相关要求
- 新世代均匀性改善及镀薄铜填孔电镀铜技术
- 线路板三防漆、电子组件封装胶和掩膜在汽车、电池、家电和消费电子产品中的应用
- 革命性之金属化制程及在 HDI-mSAP 与铜柱上之运用
- 新世代雷射曝光专用光阻于细线路类载板先进制程之应用

会议议程：

日期	时间	地点
6/12/2017 (星期三)	10:45 – 16:15	深圳会展中心
7/12/2017 (星期四)	09:15 – 16:55	四号展览馆

演讲内容详情请见附件或 [点击链接](#)

凭展会入场证**免费**参加 2017 国际技术会议，**唯名额有限，先到先得**。请即预先登记，以便为您预留席位！

会议查询及登记，请致电：

袁小姐：86-755-8624 1673 (susanyuan@hkpcb.org)
余先生：86-755-8624 1689 (patrickyu@hkpcb.org)

2017 International Technical Conference will gather a group of industry professionals to share their insights on upcoming marketing trends and technological development.

Conference Major Track：

- The Status of PCB Industry and the technology trends of PCB
- Driver for Industrial Revolution：Artificial Intelligence and Industrial Big Data
- Advances in Smart Manufacturing for PCB Production
- PCB for Emerging Products：Smart Phone and ICT
- Advancing 3D Interconnect technology
- PCB Development and Challenges for Future Automotive products
- Technological Advances in the ENIG Process
- Cleaning Trend and Related Requirements of PCB/PCBA
- SFP for IC PKG and Potential for Smartphone Advanced Pattern Plating
- Conformal Coatings, Encapsulation and Masking for Automotive, Batteries, Appliances and Consumer Electronics
- An Innovative Metallization Process for PCB Applications
- Novel Fine-line Riston® LDI Photo-resist for Advanced MSAP Application

Conference Program：

Date	Time	Venue
6/12/2017 (Wednesday)	10:45 – 16:15	Hall 4
7/12/2017 (Thursday)	09:15 – 16:55	

Details please refer to the attachment or [linkage](#)

FREE admission to International Conference for audience with visitor badge. **Limited seats available** on **first-come-first-served** basis. Please Pre-register now to ensure the seat reservation for you.

Conference Enquiry, please contact:

Ms. Susan Yuan：86-755-8624 1673
(susanyuan@hkpcb.org) Mr. Patrick Yu：86-755-8624 1689
(patrickyu@hkpcb.org)

Organizers
主办单位



Gold Sponsor
金赞助商



Silver Sponsor
银赞助商



6/12/2017 (星期三 Wednesday)

Time 时间

Topic 议题

Keynote 1 专题演讲

10:50 – 11:05

Mr. Canice Chung, Chairman, HKPCA / Executive Vice President, Asia Pacific Business Development, TTM Technologies Enterprises (HK) Ltd.
钟泰强先生, 香港线路板协会会长/ 迅达科技企业(香港)有限公司, 亚太区业务发展执行副总裁
Language 语言: English 英語



Keynote 2 专题演讲

11:05 – 11:20

Mr. John Mitchell, President & CEO,
IPC - Association Connecting Electronics Industries®
John Mitchell 先生, IPC 国际电子工业联接协会, 总裁兼 CEO
Language 语言: English 英語



The Status of PCB Industry 线路板市场概览

11:20 – 11:40

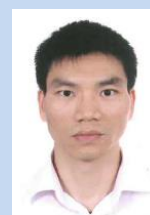
Dr. Hayao Nakahara, President, N.T. Information Ltd.
Language 语言: English 英語



Advancing 3D Interconnect technology 先进三维互连技术

11:45 – 12:10

Dr. Yaofeng Sun, Principal Engineer of Electronics Components Technology Division, ASTRI
孙耀峰博士, 香港应用科技研究院 (应科院) 有限公司, 电子组件部高级经理
Language 语言: Mandarin 普通話



12:10 – 13:45

Lunch Break 午间休息

Organizers
主办单位



Gold Sponsor
金赞助商



Silver Sponsor
银赞助商



6/12/2017 (星期三 Wednesday)

Time 时间

Topic 议题

PCB for Emerging Products : Smart Phone and ICT 智能手机及通讯设备的线路板要求

13:50 – 14:15

Mr. Erkko Helminen, Senior Manager Advanced Development - Corporate,
TTM Technologies, Inc.
Erkko Helminen 先生, 迅达科技企业(香港)有限公司, 企业先进发展高级经理
Language 语言: English 英語

PCB Development and Challenges for Future Automotive products 未来汽车产品對 PCB 的发展和挑战

14:15 – 14:40

Mr James Tam, Project Manager of Robert Bosch Co. Ltd.
譚少濂先生, 罗伯特·博世有限公司, 項目經理
Language 语言: English 英語

PCB Technology Trends PCB 发展趋势

14:40 – 15:05

Mr. David Aldape, Chief Technology Officer, Sunshine Global Circuits Co., Ltd
David Aldape 先生, 深圳明阳电路科技股份有限公司, 技术总监
Language 语言: English 英語



Driver for Industrial Revolution : Artificial Intelligence and Industrial Big Data 人工智能和工业大数据推动新的制造业革新

15:05 – 15:30

Dr. Ming Ge, Principal Consultant, Smart Manufacturing and Materials Division,
Hong Kong Productivity Council
葛明博士, 香港生产力促进局, 智能制造及材料科技部首席顾问
Language 语言: Mandarin 普通话



Advances in Smart Manufacturing for PCB Production 实际工厂中利用数据驱动对准度管控智能制造

15:30 – 16:15

Mr. Andrew G Kelly, CTO, XACT PCB Ltd.
Language 语言: English 英語



Organizers
主办单位



Gold Sponsor
金赞助商



Silver Sponsor
银赞助商



7/12/2017 (星期四 Thursday)

Time 时间

Topic 议题

Technological Advances in the ENIG Process 高性能化学镍金的技术进展

09:45 – 10:30

Mr. James Trainor, Chief Technology Consultant, Shenzhen TianXi Science & Technology Development Co., Ltd.

James Trainor 先生, 深圳市天熙科技开发有限公司, 首席技术顾问

Language 语言: English 英語



Cleaning Trend and Related Requirements of PCB/PCBA PCB/PCBA 的清洗趋势和相关要求

10:35 – 11:20

Mr. Hanker Chang, Sales Manager, ES Technology (HK) Co., Ltd.

常学良先生, 精欧科技(香港)有限公司, 业务经理

Language 语言: Mandarin 普通話



Conformal Coatings, Encapsulation and Masking for Automotive, Batteries, Appliances and Consumer Electronics

11:25 – 12:10

线路板三防漆、电子组件包封胶和掩膜在汽车、电池、家电和消费电子产品中的应用

Mr. Marufur Rahim, Director, R&D Adhesives, Global, ES Technology (HK) Co., Ltd.

Marufur Rahim 先生, 精欧科技(香港)有限公司, 全球胶粘剂研发总监

Language 语言: English 英語



12:10-13:30

Lunch Break 午间休息

Organizers
主办单位



Gold Sponsor
金赞助商



Silver Sponsor
银赞助商



SFP for IC PKG and Potential for Smartphone Advanced Pattern Plating
 新世代均匀性改善及镀薄铜填孔电镀铜技术

Mr. Robert Pan, Business Development Leader,
 Rohm & Haas Electronic Materials Asia Ltd.
 潘志远先生, 罗门哈斯电子材料亚洲有限公司, 业务发展主管
 Language 语言: Mandarin 普通话



13:30 – 14:15

Novel Fine-line Riston® LDI Photo-resist for Advanced MSAP Application
 新世代雷射曝光专用光阻于细线路类载板先进制程之应用

Dr. Mark Lin, Riston® R&D Manager, DuPont Electronic Materials
 林贤勋博士, 杜邦电子材料, 事业部研发经理
 Language 语言: Mandarin 普通话



An Innovatory Metallization Process for PCB Applications
 革命性之金属化制程及在 HDI-mSAP 与铜柱上之运用

Mr. Albert Yeh, Technical Director, Schlötter (Wuxi) Surface Technology Co., Ltd.
 叶铨强先生, 施洛特-加龙省(无锡) 表面处理技术有限公司, 技术总监
 Language 语言: Mandarin 普通话



14:20 – 15:05

High Speed, High Efficiency and High Quality – Semi Reduced Chemical Nickel Gold
 高速 高效 高品质 — 半还原型化学镍金

Mr. Ou Sheng, Factory Directory, Dongguan Guanghua Chemical Co., Ltd.
 欧胜先生, 东莞市广华化工有限公司, 厂长
 Language 语言: Mandarin 普通话



15:10 – 15:55

Substrate Materials – Core & PPG-PCB 尺寸密集化和高频化应用严格要求下的基板技术应用

Mr. Shuji Gozu, Senior R&D Manager, Hitachi Chemical Co., Ltd.
 Mr. Higgins Li, TS Manager, Hitachi Chemical Co., Ltd.
 日合津周治先生, 日立化成电子材料(广州)有限公司, 开发部市高级经理
 李海强先生, 日立化成电子材料(广州)有限公司, 技术服务部经理
 Language 语言: English 英語/ Mandarin 普通话

15:55 – 16:55

Organizers
 主办单位



Gold Sponsor
 金赞助商



Silver Sponsor
 银赞助商

